

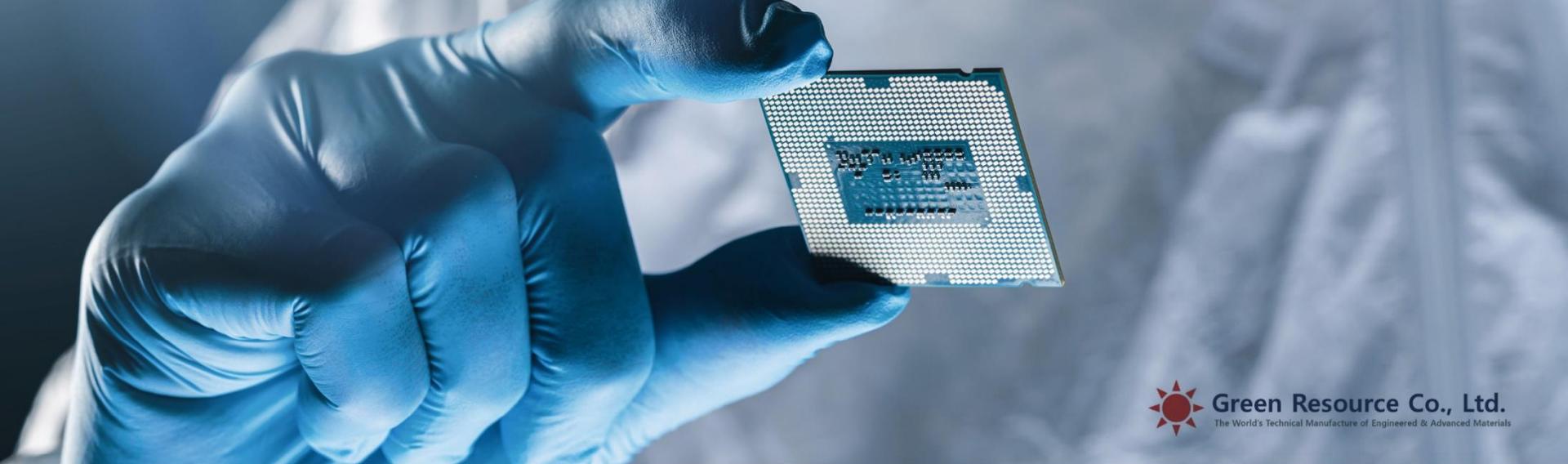
세계 최고의 독보적 반도체 초고밀도 특수코팅 기술 보유
첨단 핵심소재 부품 강소기업

INVESTOR RELATIONS 2025

반도체 소재, 표면처리, 장비

Technology Game Changer





Disclaimer

이 자료는 기관투자자와 일반투자자들을 대상으로 실시되는 Presentation에서의 정보제공을 목적으로 주식회사 그린리소스(이하 “회사”)에 의해 작성되었으며 비영리 목적으로 내용의 변경없이 사용이 가능하나 이외 영리목적의 사용과 무단변경 및 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다.

본 Presentation 에의 참석은 위와 같은 제한 사항의 준수에 대한 동의로 간주될 것이며 제한 사항에 대한 위반은 관련 증권거래 법률에 대한 위반에 해당 될 수 있음을 유념해주시기 바랍니다.

본 자료에 포함된 회사의 경영실적 및 재무성과와 관련된 모든 정보는 한국채택 국제회계기준에 따라 작성되었습니다. “예측정보”는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래에 발생할 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘예정’, 등과 같은 단어를 포함 합니다.

위 “예측정보”는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래실적은 “예측정보”에 기재 되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다. 또한, 향후 전망은 Presentation 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 변경될 수 있으며, 별도의 고지 없이 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 활용으로 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임원들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려 드립니다. (과실 및 기타의 경우 포함)

본 문서는 주식의 모집 또는 매매 및 청약을 위한 권유를 구성하지 아니하며 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다. 주식매입등 투자 관련 결정을 위한 결정은 금융감독원에 제출한 신고 및 공시를 통해 제공되는 정보만을 바탕으로 합리적인 판단으로 이루어져야 합니다.

Contents

■ Company Overview

- 01 회사개요
- 02 성장연혁
- 03 핵심사업
- 04 사업 연계 확장

■ Earnings

- 분기별 실적

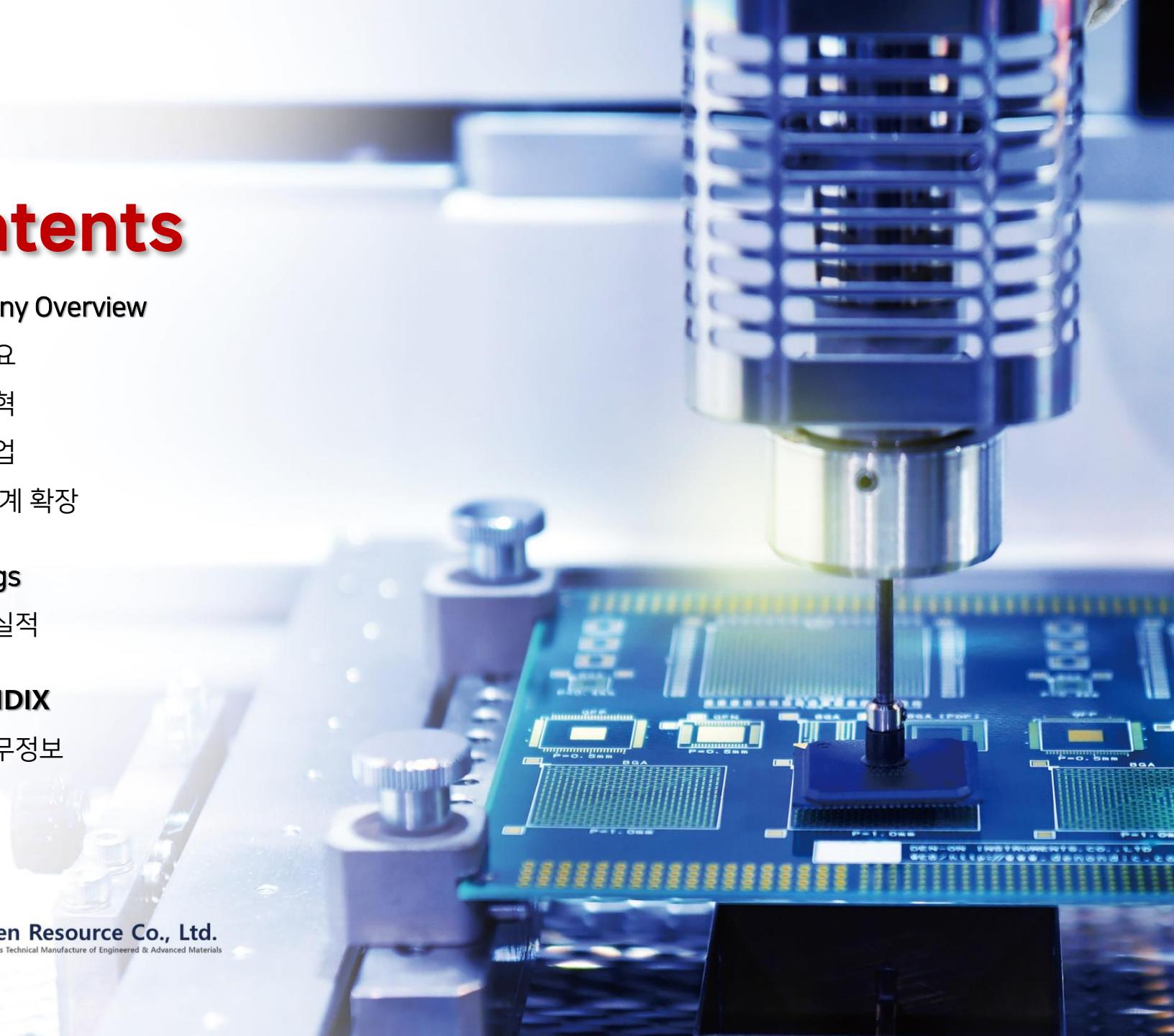
■ APPENDIX

- 요약 재무정보



Green Resource Co., Ltd.

The World's Technical Manufacture of Engineered & Advanced Materials



일반 현황

회사명	(주)그린리소스
대표이사	이종수, 이종범
설립일	2011년 4월 6일
자본금	82.8억원
주요사업	용사 코팅 및 코팅소재 (반도체 & 디스플레이) 초고밀도 코팅 (반도체) 초전도선재 제조 장비 (핵융합발전)
임직원수	85명(2025년 11월 현재, 종속회사 포함)
소재지	인천광역시 서구 파랑로 470
홈페이지	www.greenresource.kr

이 종 수 CEO (경영총괄)



- 벤처기업부장관표창
- 벤처기업진흥유공 국무총리 표창
- 나노융합대전 산업기술부문 산업통상자원부장관상
- 인천시장 표창
- 성균관대 경영대학원 MBA

이 종 범 CTO (기술총괄)

- 한국산업기술평가원 연구과제 평가위원
- 인천생산기술연구원 희소금속센터 자문위원
- 한국공학대학교 신소재공학박사



코팅 소재부터 장비, 응용 기술 내재화 및 적용 시장의 지속적 확대

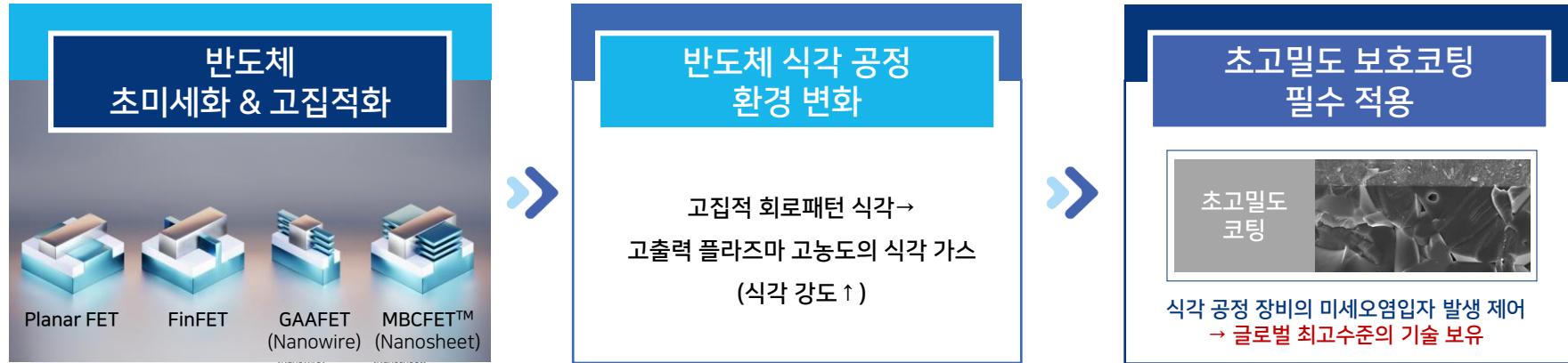


2011 회사설립
 2012 중소기업청 수출유망중소기업 선정
 2013 [반도체 디스플레이 플라즈마 식각장비 보호코팅 분말 특허등록 및 국산화 성공](#)
 2014 Nano Award 2014 산업통상부장관상 수상
 2015 반도체 초고밀도 보호코팅 특허 출원
 (글로벌 Top-Tier 기술)

2016 고밀도 후막 제조용 코팅 소재 기술 개발
 2017 [초고밀도 코팅 양산기술 확보](#)
[Global Foundry 식각장비 보호코팅 메인벤더 등록](#)
 2018 (주)파이널텍 출자 설립(100% 자회사)
 벤처기업진흥유공 국무총리 표창 수상
 초고밀도 코팅 특허 등록
[중국 1위 식각장비 기업\(NAURA\) 코팅 부품 공급](#)
 2019 뿌리기술전문기업 지정
 삼백만불 수출의 탑
[LG디스플레이 식각장비 보호코팅 공급업체 등록](#)

2020 (주)위드엘씨 지분인수 및 100% 자회사 편입
 다중전극 구조 플라즈마 용사 장치 개발
 글로벌 선도 고객사 초고밀도 코팅 적용
 2021 초고밀도(특수소재) 코팅 원천기술 확보
 Micron(대만) 특수코팅 양산 승인
 초전도선재 장비 및 소재사업부 신설 및 장비 수주
 (In-line IBAD system)
 2022 글로벌 강소기업 지정
 글로벌 선도 고객사 초미세 공정 코팅 적용
 2023 KIOXIA(구, TOSHIBA) 식각장비 부품코팅 적용
 2023 코스닥 상장
 2024 세라믹 부품 회사 CEK 인수
 2025 자회사 파이널텍 초전도선재 양산라인 구축

10nm이하 반도체 식각 공정의 수율 상승을 위한 필수 보호코팅



글로벌 파운드리 3사 선단공정 Roadmap

Foundry	2024	2025	2026	2027	2028	2029+
SAMSUNG	SF3 (2 세대 3nm, 양산)	SF2 (Mobile 양산), SF4U	SF2 (HPC 용), 8nm eMRAM	SF2 (Automotive), SF2Z (BSPDN)	SF2 기반 파생 고도화 (SF2P+)	SF1.4 (예상 양산 시점)
tsmc	N3E (대량 양산)	N2 (H2 양산, GAA 도입)	N2P (성능 강화), N2X (HPC), A16 (말, SPR 도입)	A16 (대량 양산), N2 (미국 패그동)	A14 (대량 양산)	A14 파생 공정
intel	18A (Risk Production)	18A (HVM), Panther Lake 출시	14A (개발 및 Risk Production)	14A (양산), 12nm (UMC 협력)	14A-E (기능 확장), 10A (연구)	10A (AI 완전 자동화 패 목표)
비고	GAA 도입 경쟁 심화	2nm 시대 개막, 삼성 SF4U 도입	후면전력공급 (BSPDN) 전면화	삼성 1.4nm 자연 가능성, 인텔 12nm 양산	나노시트 기술 성숙기	삼성 1.4nm 본격화 예상.

*자료 : TrendForce 및 업계 발표 기반 재구성 (2025.12 기준 최신 로드맵 반영)

반도체 건식 식각장비의 핵심 부품 보호코팅

초고밀도(Super Dense) 코팅

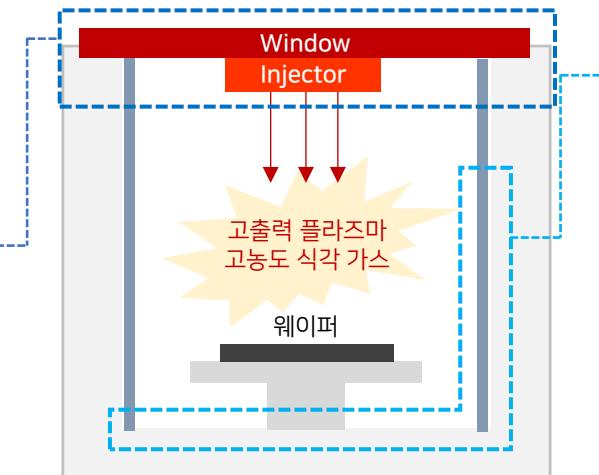
자체 개발한 PVD 방식의 초고밀도 코팅으로 식각 챔버의 상부 부품 등 핵심 부품에 대한 내플라즈마 코팅



[Window 및 Injector 등]

“세계 최고 수준의 독보적 기술”

[건식 식각 공정 챔버]



SPS(Suspension Plasma Spray) 코팅

기존 APS 코팅 대비 치밀한 코팅막 형성으로 높은 밀도와 수명을 구현하는 차별화된 기술



[GDP, Inner liner, Outer liner, Shutter 등]

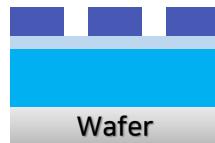
“기존 APS코팅 대체 선도 기술”

반도체 주요 공정

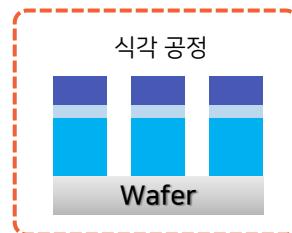
증착 공정



노광 공정



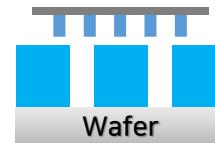
식각 공정



박리 공정



세정 공정



증착 공정



반도체 및 디스플레이 산업 밸류체인내 다양한 시장 수요 창출



반도체 제조사



반도체 식각 장비사



디스플레이 제조사



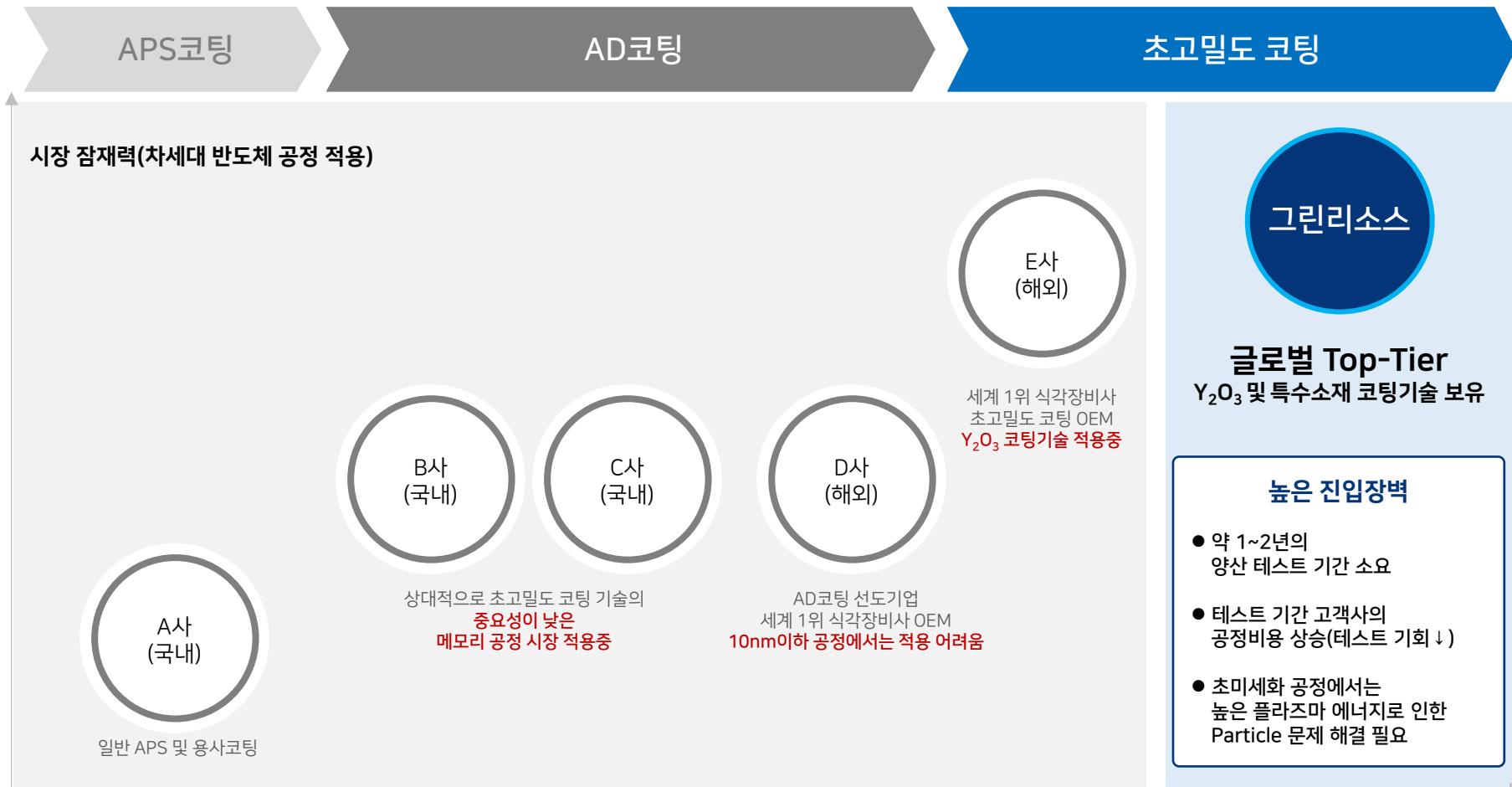
디스플레이 식각 장비사



장비 공급

장비 공급

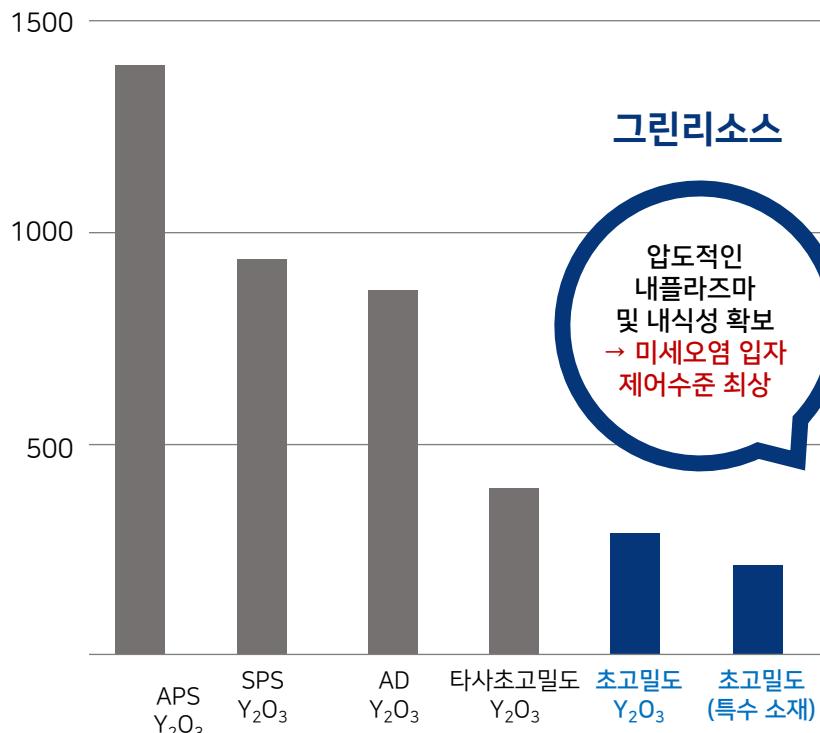
차세대 반도체 공정에서 필요로 하는 초고밀도 코팅 시장 선도



Total Coating Solution 기반 타사 대비 압도적인 내플라즈마 코팅막 형성

Etch Rate(nm/h)

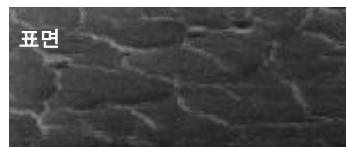
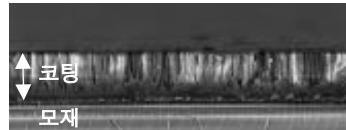
(단위 : nm/h)



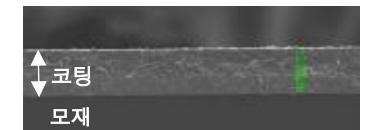
그린리소스

압도적인
내플라즈마
및 내식성 확보
→ 미세오염 입자
제어수준 최상

일반 초고밀도 코팅

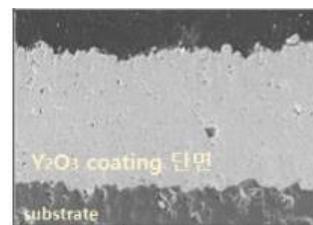


당사 초고밀도 코팅

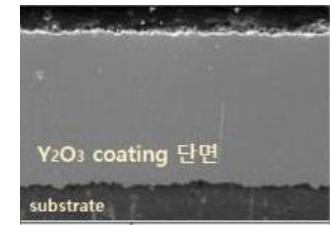


일반 초고밀도 코팅 대비 코팅 응력 제어를 통한
표면 크랙 및 기공 없이 두꺼운 코팅 (>20μm) 형성

해외 SPS 장비사용 코팅



자체개발 SPS 장비사용 코팅



해외에 의존하고 있는 코팅장비와 소재의 국산화 및 특히 확보
기준 SPS 코팅막보다 경도와 밀도가 더 높은 코팅막 형성

*자료 : 회사 자체 분석

코팅 소재부터 장비, 코팅 기술까지 자체 기술 보유로 원스톱 솔루션 제공

코팅 소재
제조 기술

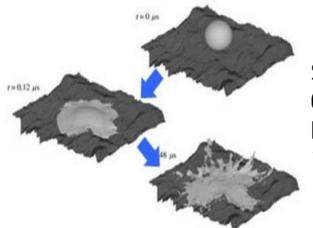
코팅 장비
개발 기술

코팅(제품)
기술

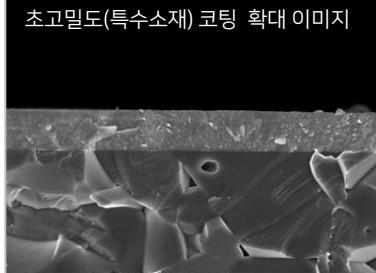
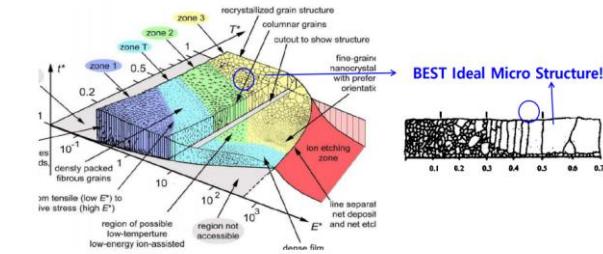
고순도/고기능성 코팅 소재
제조 원천 기술 보유

공정 최적화 장비
설계 및 디자인

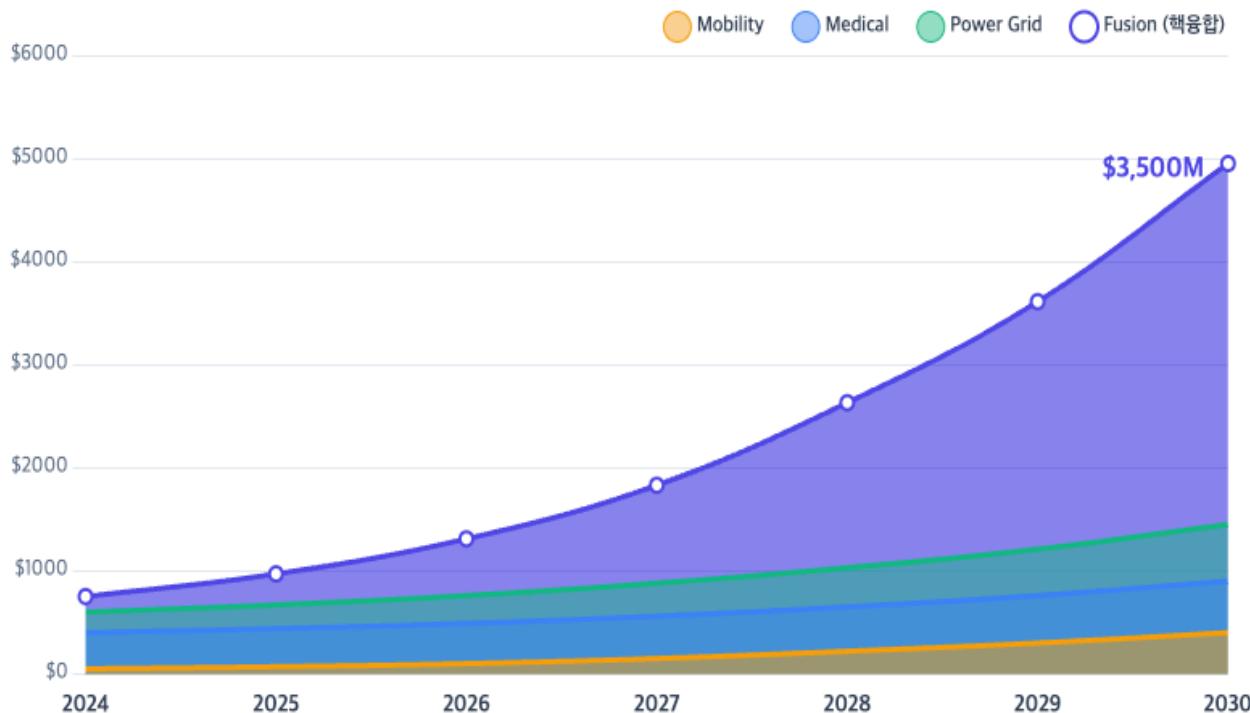
초고밀도/고내식성 코팅 기술
(고객사 평가 우수)



SPS Coating Powder:
0.5~10 μ m
Normal APS Coating Powder:
10~45 μ m



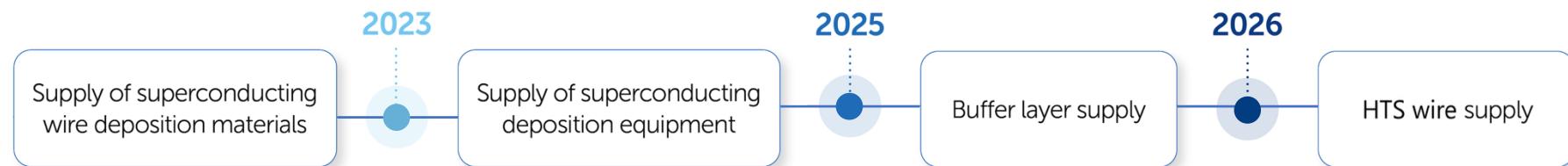
Global HTS Wire Market Forecast(2024-2030)



 **Fusion (핵융합)** **+45% CAGR**
2027년 실증로 건설 시작과 함께 J-Curve 성장
견인. 2030년 전체 시장의 60% 이상 점유 예상.

 **Power Grid** **Stable**
AI 데이터센터 및 도심 송전망 효율화 수요.

 **Medical (MRI)** **Solid**
초고해상도 MRI 및 암 치료용 가속기 수요.



소재 공급 / 부품 설계•제작 및 공급 / 생산장비 설계•제작 및 공급

핵심 소재 국산화 및 재활용 기술 확보로 가격 경쟁력 확보



소재 · 부품 · 장비 수직계열화를 통한 경쟁력 확대



Materials

파우더 & 타겟
고순도 원료 직접 생산으로
원가 경쟁력 확보

CASH COW



Key Parts

이온 소스 & 캐소드
핵심 부품 내재화를 통한
기술 진입 장벽 구축

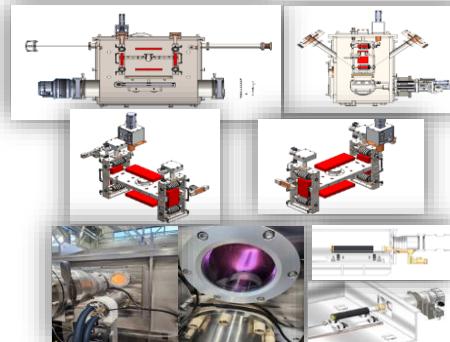
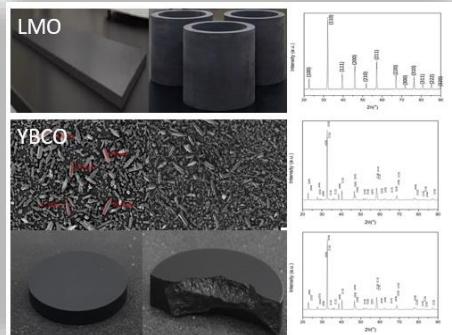
TECH CORE



Equipment

IBAD & PLD System
양산형 턴키 장비 공급
글로벌 시장 진출

HIGH VALUE



글로벌 초전도 선재 시장의 패러다임 전환과 핵심 공급망의 부상

Global Key Players

 (미국)	 (일본)	
		
		
 (중국)	 (유럽)	 (한국)
		



시장 핵심 변화 3가지

- [시장 이동]
 - 국책 과제(ITER) → 민간 소형 핵융합(Compact Fusion)
 - 국책 과제(ITER)  → 민간 소형 핵융합(Compact Fusion) 
- [경쟁 심화]
 - 중국(SST), 연 4,000km 증설  VS 
 - 서방 진영, Friend-shoring 구축
- [기회 요인]
 - 폭발적 수요 
 - 공급 부족 (Supply Shock) 
 - 타겟(Target) 및 장비 코팅, 업스트림(Upstream) 기술 가치 급상승. 

Green Resource



반도체 소부장 연계 & 확장

친환경 재활용 & 에너지 사업

그린블랙테크

폐타이어
리사이클링

아시아에너지

'27 IPO 목표
바이오중유
항공유 등

엠디바이스

25년 3월 상장
반도체 Advaced
packging 협업

그린리소스

반도체 코팅
초전도선재 장비
ESC 등

중국 진출
영업 네트워크
약23%지분 취득

중국
SYMC

핵융합발전용
초전도선재
양산라인 구축 중

파이널텍

디스플레이 세정
반도체
아노다이징

'28 IPO 목표
반도체세라믹
Si, Sic 등
확장

위드엘씨

씨이케이

합병완료 25.06.30

종속기업(51%~100%)

관계기업(20%~50%)

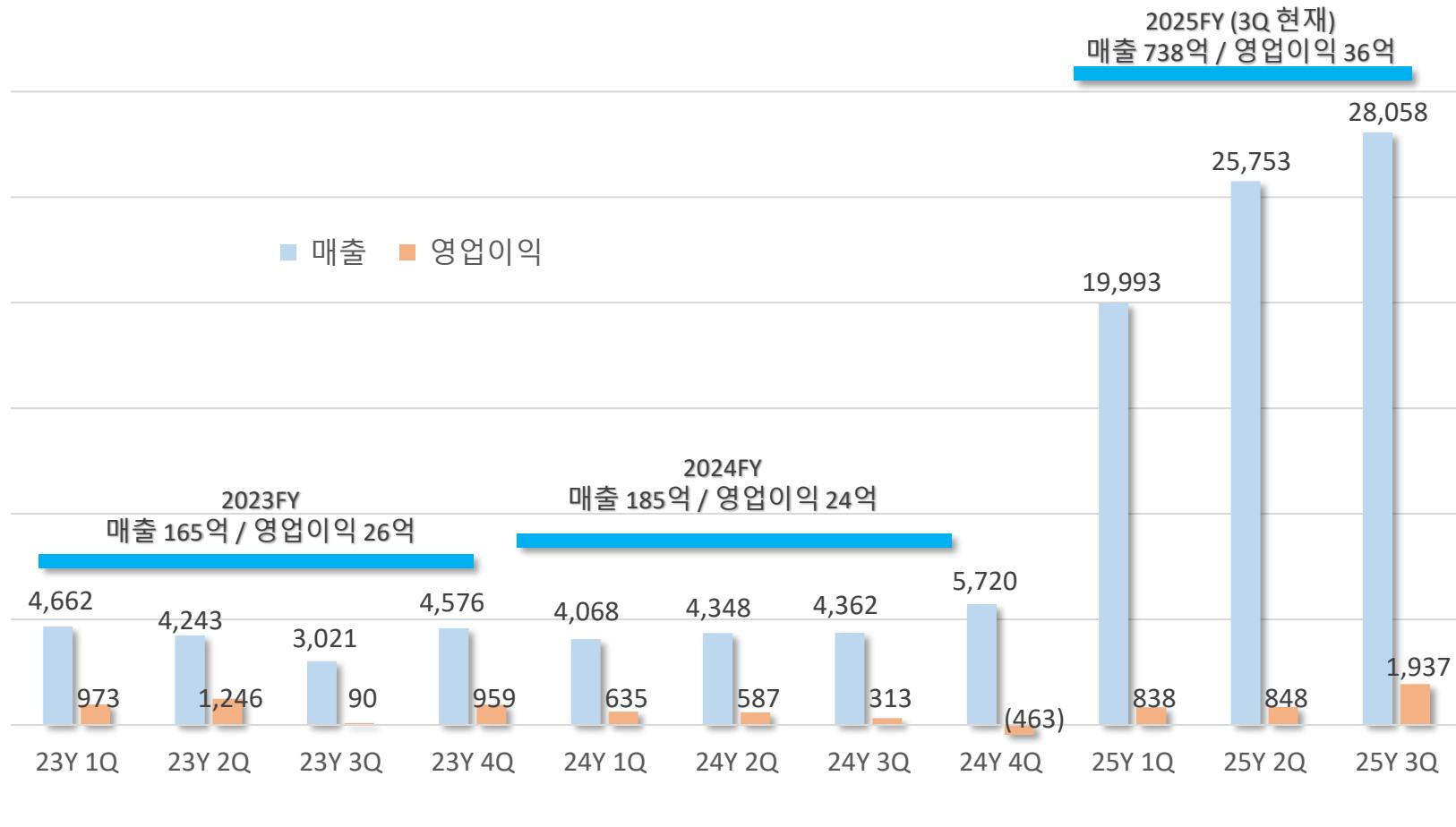
투자기업(01%~20%)

Earnings

○ 분기별실적



01 분기별 실적(연결)



단위 : 백만원

Appendix

○ 요약재무제표



01 요약재무제표(연결)

재무상태표

구분	2022	2023	2024	2025 3Q
유동자산	8,645	21,246	28,200	42,987
비유동자산	26,074	50,091	83,642	98,027
자산총계	34,719	71,337	111,842	141,014
유동부채	11,188	10,347	40,039	61,102
비유동부채	2,560	9,860	10,258	6,466
부채총계	13,748	20,207	50,297	67,568
자본금	3,247	4,092	4,133	8,279
자본잉여금	4,031	30,598	31,950	27,945
기타자본	303	449	4,935	5,143
기타포괄손익	-	-	-	-19
이익영여금	13,389	15,991	18,307	30,003
비지배지분	-	-	2,220	2,094
자본총계	20,970	51,130	61,545	73,446

단위: 백만원

손익계산서

구분	2022	2023	2024	2025 3Q
매출액	25,084	16,501	18,499	73,804
매출원가	17,028	9,524	12,408	64,874
매출총이익	8,056	6,977	6,091	8,929
판매비와관리비	4,325	3,079	5,019	5,307
영업이익	3,731	3,268	1,072	3,624
영업외수익	675	512	4,046	13,420
영업외비용	328	374	3,510	4,113
법인세차감전이익	4,078	3,406	1,609	12,930
법인세비용	613	804	799	1,080
당기순이익	3,465	2,602	2,406	11,850

단위: 백만원

02 요약재무제표(별도)

재무상태표

구분	2022	2023	2024	2025 3Q
유동자산	7,407	19,131	21,417	38,759
비유동자산	24,784	49,238	72,688	85,064
자산총계	32,191	68,369	94,106	128,823
유동부채	10,648	9,736	34,235	53,171
비유동부채	2,428	9738	3,807	2,144
부채총계	13,076	19,474	38,042	55,315
자본금	3,247	4,092	4,133	8,279
자본잉여금	4,031	30,599	31,950	27,945
기타자본	304	449	4,935	4,863
기타포괄손익	0	0	0	-19
이익영여금	11,534	13,756	15,045	27,440
비지배지분	0	0	0	0
자본총계	19,115	48,895	56,063	68,508

손익계산서

구분	2022	2023	2024	2025 3Q
매출액	21,432	12,192	13,902	65,234
매출원가	14,754	6,824	9,515	58,109
매출총이익	6,678	5,368	4,387	7,125
판매비와관리비	3,255	2,995	3,923	3,425
영업이익	3,423	2,373	464	3,700
영업외수익	661	466	3,878	13,013
영업외비용	310	359	3,421	3,660
법인세차감전이익	3,774	2,480	921	13,053
법인세비용	725	258	-369	658
당기순이익	3,049	2,222	1,290	12,394